

第27回 有機/無機接合研究委員会

日時：2026年3月10日（火）13:30～16:30

場所：東京たま未来メッセ 東京都立多摩産業交流センター（オンライン併用開催）

プログラム

司会 山口 敦史（パナソニック インダストリー(株)）

13:30～13:40 委員会議事

13:40～14:20

『3D プリンターを利用した鉄鋼と樹脂の異材接合』（40 分）

.....○田中 努^{*1}, 木村 貴広^{*1}, 中本 貴之^{*1}, 内田 壮平^{*1}, 平田 智丈^{*1}, 片桐 一彰^{*2}
（^{*1}大阪産業技術研究所, ^{*2}広島大学）

14:20～15:00

『固体イオン交換法を援用したガラス内銀析出現象の動的観察および評価』（40 分）

..... ○河野 美優香, 松坂 壮太, 比田井 洋史（千葉大学）

15:00～15:10 休憩

司会 渡辺 潤（OKI ネクステック(株)）

15:10～15:50

『エポキシ樹脂の硬化反応へのシリカフィラーの影響に関する解析』（40 分）

. ○仲 啓志^{*1}, 古島 圭智^{*1}, 平野 孝行^{*1}, 田口 嘉彦^{*1}, 鳥越 寛史^{*2}, 高尾 知哉^{*2}, 高瀬 睦^{*2},
農宗 辰己^{*2}, 石川 有紀^{*2}, 石井 健治^{*2}（^{*1}(株)東レリサーチセンター, ^{*2}サンユレック(株)）

15:50～16:30

『高信頼性アンダーフィル材開発に向けた内部ひずみを用いた寿命評価アプローチ』（40 分）

..... ○吉田 拓弥, 榎本 利章, 阿部 早苗, 山口 博（ナミックス(株)）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会